

**关键指标**

频率: 6~14GHz  
增益: 9.5dB  
1dB 压缩点输出功率: 16.5dBm  
电压/电流: +5V/38mA  
芯片尺寸: 1.1mm×0.95mm×0.1mm

**产品简介**

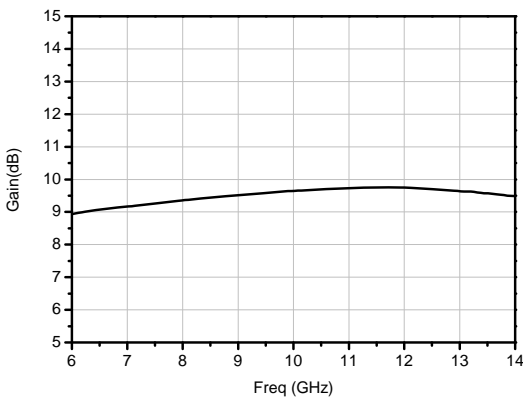
HG125F-1 是一款 6~14GHz 驱动放大器芯片, 增益为 9.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 16.5dBm。

**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)**

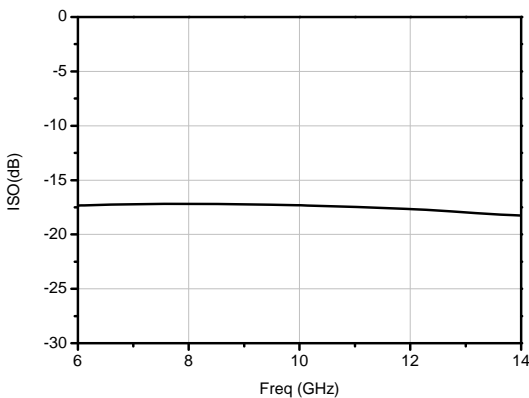
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~14		
增益(dB)	-	9.5	-
增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.1	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	16.5	-
静态电流 (mA)	-	38	-

**典型测试曲线**

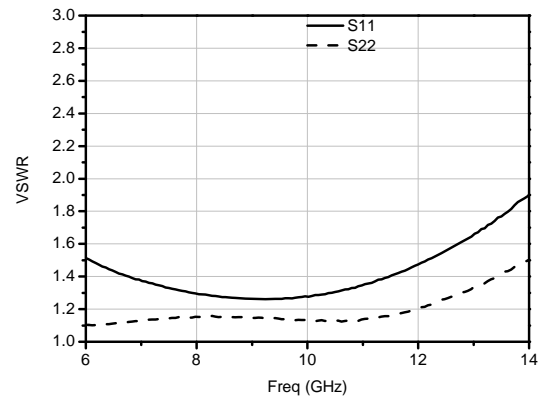
增益



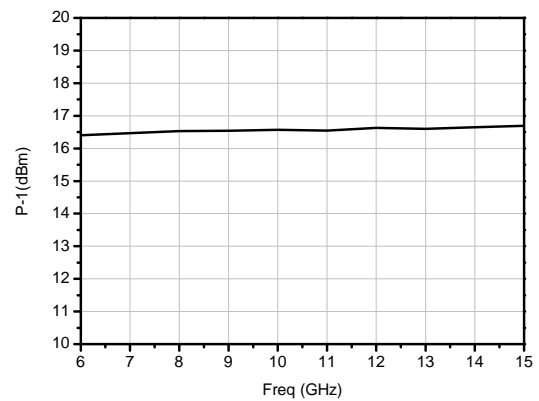
反向隔离度



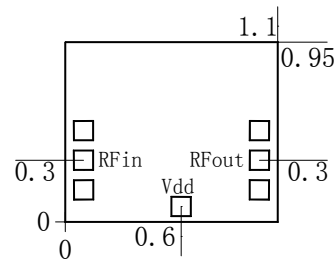
驻波



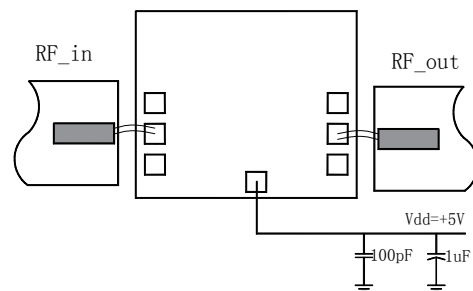
1dB 压缩点输出功率



**外形和端口尺寸 (mm)**



**推荐装配图**



### 绝对额定最大值

电源电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50 $\mu$ m 双金带键合，建议金带长度 250~400 $\mu$ m；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。